

ICS 31.180
L30
备案号: 50611-2015



中华人民共和国电子行业标准

SJ/T 11534—2015

微波电路用
覆铜箔聚四氟乙烯玻纤布层压板

Copper-clad PTFE woven glass fabric laminate for microwave circuit

2015 - 04 - 30 发布

2015 - 10 - 01 实施

中华人民共和国工业和信息化部 发布

前 言

本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机关不承担识别这些专利的责任。

本标准由全国印制电路标准化技术委员会（SAC/TC203）提出并归口。

本标准负责起草单位：泰州市旺灵绝缘材料厂、咸阳瑞德电子科技有限公司、江苏省电子信息产品质量监督检验研究院，工业和信息化部电子工业标准化研究院。

本标准起草人：顾根山、高艳茹、朱德明、施吉连、裴会川、宋继军。

微波电路用覆铜箔聚四氟乙烯玻纤布层压板

1 范围

本标准规定了微波电路用覆铜箔聚四氟乙烯玻纤布层压板（以下简称覆铜板）的分类、各项技术要求、检验方法、检验规则、标志、包装、储存及运输要求。

本标准适用于E玻纤布渍聚四氟乙烯乳液，经烘干、烧结成的聚四氟乙烯预浸料，单面或双面覆铜箔热压制成的覆铜箔层压板。未覆箔层压板也可参照使用。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用标准，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 1033.1 塑料密度和相对密度试验方法
- GB/T 2036 印制电路术语
- GB/T 4721 印制电路用刚性覆铜箔层压板通用规则
- GB/T 4722 印制电路用刚性覆铜箔层压板试验方法
- GB/T 5230 印制板用铜箔
- GB/T 7265.1 固体电介质微波复介电常数的测试方法-微扰法
- GB/T 12636 微波介质基片复介电常数测试方法
- SJ/T 11283 印制板用E玻纤布规范

3 术语和定义

GB/T 2036确立的以及下列术语和定义适用于本文件。

3.1

整张板 fabricated sheet

长度和宽度与制造厂标称尺寸相同的覆箔板和未覆箔板。

3.2

剪切板 cut-to-size panel

按用户要求裁剪成一定尺寸的覆箔板和未覆箔板。

4 分类 结构和材料

4.1 分类

覆铜板按特性（介电常数、损耗因数）和构成不同进行分类，型号、特性及构成见表1。